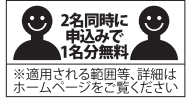


◎ECTCでの発表からパッケージング技術の動向を把握！

◎3D積層、チップ・ツー・ウエハ集積、FOW(P)LP、チップレット等の先端PKGとその材料・プロセス技術動向がわかる



【Live(リアルタイム)配信】 先端半導体パッケージのキーテクノロジーと研究動向 —国際会議ECTCの発表を中心にTSV, Cu/Cu接合, FOWLP, チップレットFHE, μLED, 自己組織化実装まで—



日時	2021年2月25日(木) 13:00~17:00	会場	Live配信セミナー ※会社・自宅にいながら学習可能です※
受講料	44,000円 ⇒テレワーク応援キャンペーン 【Live配信/WEBセミナー受講限定】 1名申込みの場合:受講料 定価:35,200円/S&T会員 33,440円 ※ 同一企業から複数名S&T会員で受講される場合は本割引ではなく、「2名同時申込みで1名分無料」割引を適用させていただきます。	資料付	

講師 東北大学 大学院工学研究科 機械機能創成専攻 准教授 福島 誉史 氏

趣旨 世界最大の半導体パッケージング技術に関する国際会議であるECTCでの発表内容を中心に東北大学等の研究開発例を加え、先端の半導体パッケージで必要とされる材料やプロセス技術の詳細を解説します。
再度注目を集めるシリコン貫通配線(TSV)を主とする三次元積層技術、発表件数が増えるCu-Cuハイブリッド接合によるチップ・ツー・ウエハ集積、ここ5年間で最も注目を集めた新しい半導体パッケージ形態FOWLP、来年度注目の的となるチップレットを用いた半導体パッケージに加え、次世代のフレキシブルデバイスとして期待されるフレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクス(FHE)、ブラウン管が液晶に変わった以上の技術革新とも言われるμLEDディスプレイの鍵を握るマストランスファや自己組織化によるアセンブリなどの実装技術を詳しく紹介します。

プログラム	1. 半導体パッケージング技術最大の国際会議ECTCに見る研究開発動向	3. FOWLPの現状と研究動向 3.1 実装方式の分類(Die-first, RDL-first, InFO)と技術課題 3.2 パネルレベルFOWLPを含めた最近の研究紹介 3.3 Pick & Placeと自己組織化実装
	2. 三次元実装と三次元集積 2.1 三次元積層型集積回路の歴史 2.2 三次元シリコンインターポーザ(2.5D技術)とEMIB 2.3 モノリシックv.s.マルチリシック 2.4 Chip-to-Chip, Wafer-to-Wafer, Chip-to-Wafer, Multichip-to-Wafer 2.5 High-Bandwidth Memory (HBM)からCoWoS、人工知能チップへの応用 2.6 TSV作製工程の詳細と技術課題 2.7 マイクロバンプ接合とCu-Cuハイブリッド接合 2.8 先端半導体パッケージに要求される高分子材料 2.9 ウエハ薄化技術とウエハエッジの影響 2.10 自己組織化チップ実装技術(セルフアセンブリ) 2.11 三次元積層型集積回路と信頼性解析技術	4. チップレットと半導体パッケージング 4.1 チップレットとは? 4.2 チップレットを用いた半導体パッケージング技術の現状と展望 5. 柔軟デバイスの最前線:フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクス(FHE) 5.1 リジッド/フレキシブル複合基板から有機半導体まで 5.2 プリント配線技術 5.3 極薄単結晶半導体チップの実装と研究事例 5.4 チップレット内蔵FHEの研究事例 6. マイクロLEDディスプレイとアセンブリ技術 7. おわりに

本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信となります。予め「Zoom」のインストールが可能か、接続可能か等をご確認ください。セミナー資料は電子ファイルでの配布、郵送のいずれかになります。詳細はホームページをご確認ください。

■2名同時申込みで1名分無料■
(1名あたり定価半額の22,000円)

※2名様ともS&T会員登録をしていただいた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

セミナー申込用紙 B210255 (先端半導体パッケージ)

会社名 団体名			
部署			
役職	〒		
ふりがな	住所		
氏名			
TEL	FAX		
E-mail	※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。		

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。
※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

今後のご案内	
<input type="checkbox"/> E-mail希望・登録済み	S&T会員価格を適用いたします。 (E-mailアドレス必須)
<input type="checkbox"/> 郵送希望・登録済み	
<input type="checkbox"/> 希望しない	
お支払方法	
<input type="checkbox"/> 銀行振込 (振込予定日 月 日)	
通信欄	

●受講料について
「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。
●お申込みについて
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。
また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。
お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。
●お支払いについて
受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、もしくは当日現金にてお支払いください。
銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。
振込手数料はお客様がご負担ください。

●個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。
詳しくはホームページをご覧ください。
●キャンセル規定
開催日から逆算(営業日:土日・祝祭日等を除く)いたしまして、
・開催7日前以前のキャンセル: キャンセル料はいただきません。
・開催3~6日前でのキャンセル: 受講料の70%
・開催当日~2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100%
※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により中止になる場合がございます。

サイエンス & テクノロジー
研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍
サイエンス&テクノロジー株式会社
TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187
〒105-0013
東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F
https://www.science-t.com